

2011 年 8 月吉日

お客様各位

株式会社東芝 社会インフラシステム社
電波システム営業部 マイクロ波営業担当

東芝マイクロ波半導体製品のプロセス変更通知(PCN)

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
この度、弊社製品の製造方法の一部変更を行いますのでご連絡致します。
変更内容の詳細は下記のとおりです。

— 記 —

1. 対象製品：

PKG 入りマイクロ波半導体製品全般が対象となります。

2. 変更内容：

内部配線(Au ワイヤ)のボンディング方法にボールボンディングを導入致します。

尚、ボールボンディングの信頼性については検証済みであり、製品への適用はRF性能が従来品と同等であることを確認した上で行いますので、製品名、製品規格、パッケージに変更はありません。

3. 変更理由：

ウェッジボンダの生産中止に伴う設備の更新のためです。

4. 変更時期

製品への適用は、2011 年 10 月以降順次進めます。

詳細計画を別紙に示します。尚、本計画は予告なく変更する場合がありますのでご了承願います。

以上

	2011下期		2012上期		2012下期		2013上期		2013下期		2014上期	
C帯IM FET製品	TIM5964-35SLA TIM5964-60SL TIM7785-60SL TIM5964-45SL	TIM7785-45SL		35W級製品	60W級製品	45W級製品	16W級製品	80W級製品	4W級製品	8W級製品	30W級製品	6W級製品
												12W級製品
X-Ku帯IM FET製品	TIM1414-30L TIM1314-30L	TIM1414-18L TIM1314-15UL		30W級製品	18W級製品	10W級製品	8W級製品	5W級製品	4W級製品	2W級製品		
						15W級製品	9W級製品	7W級製品				
GaN HEMT製品						TGI7785-50L TGI7785-120L TGI8596-50	TGI0910-50 TGI1314-50L TGI1414-50L					
MMIC製品								MMIC製品				

※なお、本計画は予告なく変更する場合があります。